

## 希荻微电子集团股份有限公司

# 关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日